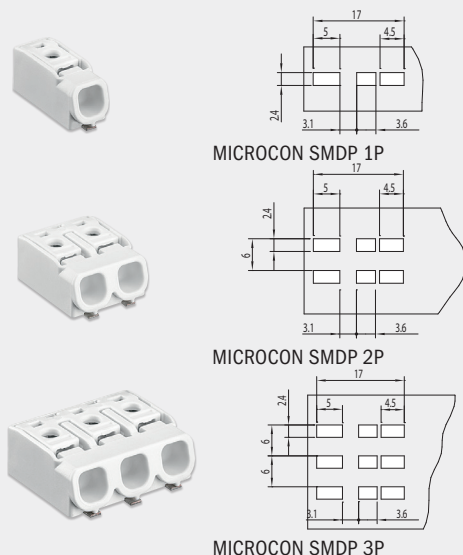


1. Produkt und Leiterplatten Lötbild | Product and PCB Layout

Empfohlener Lötpastenauftrag (Schablonenstärke): 0,12 mm
Schablonenkontur, wenn nicht anderslautend in der Bedienungsanleitung angegeben, deckungsgleich mit dem Leiterplattenlayout.

*Recommended solder paste application (stencil thickness): 0.12 mm
Unless otherwise specified in the operating instructions, the stencil outline is congruent with the PCB layout.*

**Angaben für den Reflow Lötprozess:**

Lötprofil in Anlehnung an JEDEC J-STD-020/E Bild 5-1 für bleifreie Baugruppen bis zu einer Maximaltemperatur von 260°C.
Da der Lötprozess weiteren Einflussfaktoren wie z.B. Lötpaste, Fertigungsanlage, Leiterplattenparameter unterliegt, empfehlen wir die Durchführung von Verarbeitungstests und die Erstellung eines optimalen Lötprofils unter realen Fertigungsbedingungen im Zuge des Design-in Prozesses. Im Zuge des Lötprozesses kann es zu geringfügigen Verfärbungen des Kunststoffmaterials kommen, welche keinen Einfluss auf die Funktion der Klemme haben.

Specifications for the reflow soldering process:

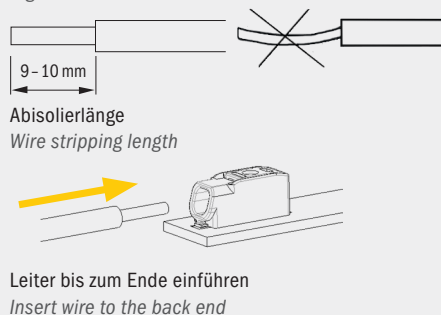
Soldering profile following JEDEC J-STD-020/E Figure 5-1 for lead-free assemblies up to a maximum temperature of 260°C.

As the soldering process is subject to other influencing factors such as solder paste, production equipment, PCB parameters, we recommend carrying out processing tests and establishing an optimum soldering profile under real production conditions in the course of the design-in process. The soldering process may cause slight discolorations of the plastic material, which have no influence on the function of the terminal.

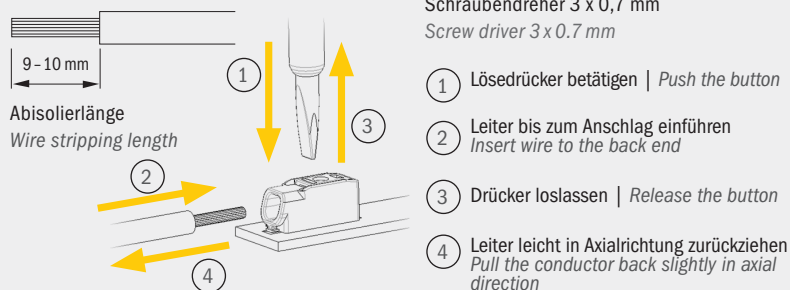
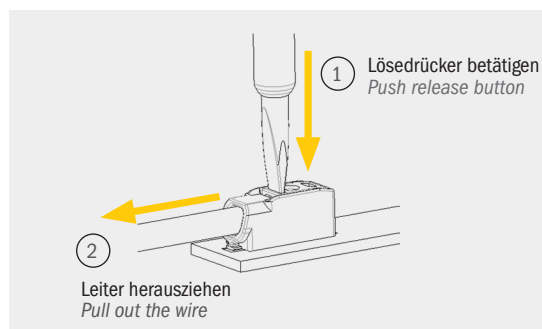
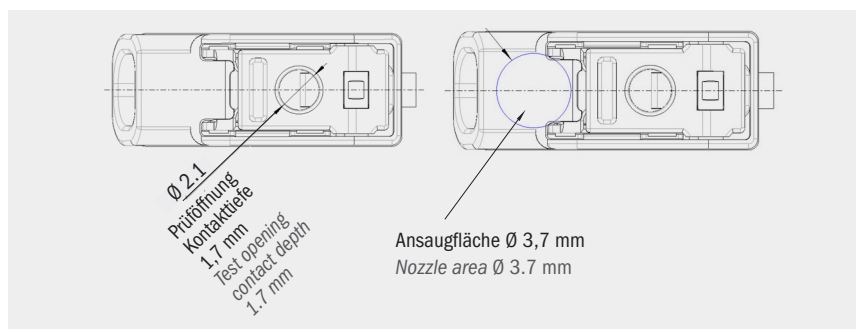
CAUTION: NOT FOR INTERRUPTING CURRENT
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT

3. Leiter einführen | Wire insertion

Starre Leiter 0,2 – 2,5 mm²
Rigid wires 0.2 – 2.5 mm²



Flexible Leiter 0,2 – 2,5 mm²
Flexible wires 0.2 – 2.5 mm²

**4. Leiter lösen | Wire release****5. Prüfoffnungen und Bestückungsinformation
Test openings and pick & place information****6. Kriech- und Luftstrecken | Creepage- and clearance distances**

Kriech- und Luftstrecken sind durch den Einbau sicherzustellen. Für Hilfestellung bezüglich Auslegung der Leiterplattenabstände nach UL Vorgaben, abhängig vom Anwendungsbereich, kontaktieren Sie bitte unser Team: office@electroterminal.com

Creepage distances and clearances must be ensured by correct placement on the PCB. For assistance regarding the design of spacings according to UL requirements, depending on the application area, please contact our team: office@electroterminal.com



MICROCON SMDP
Video auf Youtube
Video on Youtube

**ELECTRO-
TERMINAL**